

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-142886

(43)Date of publication of application : 02.06.1995

(51)Int.Cl.

H05K 7/20
H01L 23/473

(21)Application number : 05-284855

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 15.11.1993

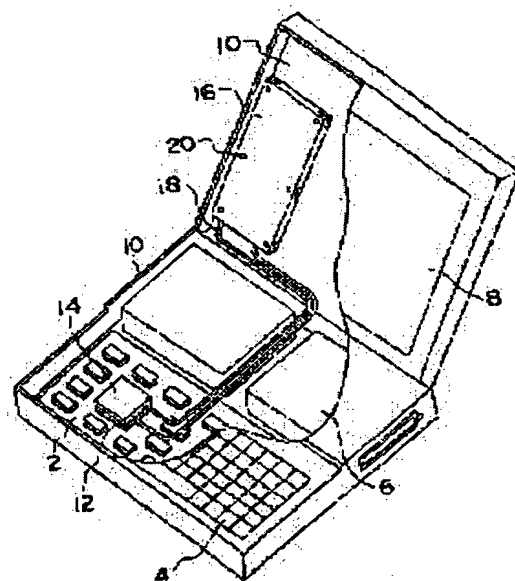
(72)Inventor : OHASHI SHIGEO
HATADA TOSHIO
TANAKA SHINJI

(54) ELECTRONIC DEVICE COOLER

(57)Abstract:

PURPOSE: To efficiently transfer heat on a heat generating member to a metal housing wall being a heat radiating part for cooling the heat generating member even in a device with the heat generating member mounted in a small housing together with other members.

CONSTITUTION: A heat generating member and a metal housing wall are thermally connected to each other by a heat transfer device having a flexible structure. The heat transfer device comprises a flat heat receiving header 14 having a liquid flow path attached to the heat generating member, a heat radiating member 16 having a liquid flow path and in contact with a wall of the metal housing and a flexible tube 18 for connecting both, wherein liquid sealed inside is driven or circulated between the heat receiving header and the heat radiating part by a liquid driving mechanism housed in the heat generating member. Thus the heat generating member and the housing wall can be easily connected to each other irrespective of arrangement of components, and also heat can be transferred highly efficiently by driving the liquid. Since the heat generating member and the metal housing wall are thermally connected at the heat radiating part, the heat can be diffused widely on the housing wall due to high heat conductivity of the housing, thereby obtaining high heat radiating performance.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 06.11.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 03.09.2002

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-142886

(43)公開日 平成7年(1995)6月2日

(51)Int.Cl.⁶

H 0 5 K 7/20

識別記号

R

F

庁内整理番号

H 0 1 L 23/473

F I

技術表示箇所

H 0 1 L 23/ 46

Z

審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 8 頁)

(21)出願番号 特願平5-284855

(22)出願日 平成5年(1993)11月15日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 大橋 繁男

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

(72)発明者 畑田 敏夫

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

(72)発明者 田中 伸司

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日

立製作所機械研究所内

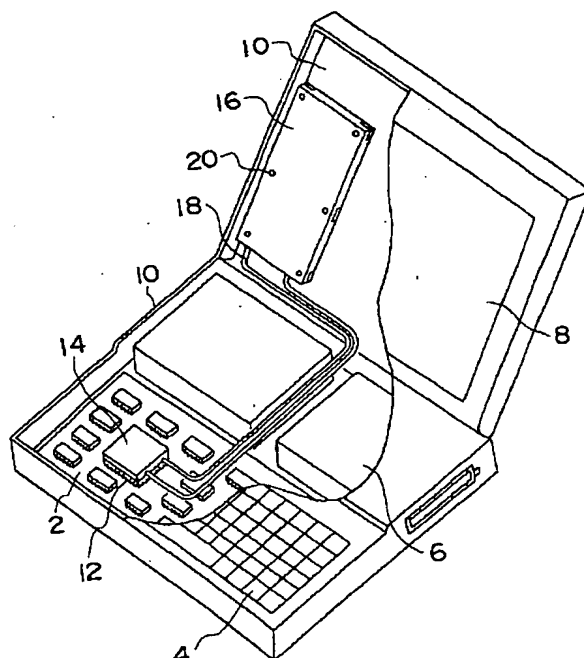
(74)代理人 弁理士 鶴沼 辰之

(54)【発明の名称】 電子機器冷却装置

(57)【要約】

【目的】 発熱部材を他の部材と共に狭い筐体内に搭載した装置でも、発熱部材の発生熱を放熱部である金属筐体壁まで効率良く輸送し発熱部材を冷却する。

【構成】 発熱部材と金属筐体壁とをフレキシブル構造の熱輸送デバイスにより熱的に接続した。熱輸送デバイスは発熱部材1に取り付けた液流路を有する扁平状の受熱ヘッド14、液流路を有し金属筐体10の壁に接触させた放熱部材16、及び両者を接続するフレキシブルチューブ18で構成され、内部に封入した液を放熱部材に内蔵した液駆動機構により受熱ヘッドと放熱部との間で駆動あるいは循環させた。これにより、発熱部材と筐体壁とが部品配列に左右されることなく容易に接続されると共に、液の駆動により高効率で熱が輸送される。放熱部においては、放熱部材と金属製筐体壁とが熱的に接続されているので、金属製筐体の高い熱伝導率のために熱が広く筐体壁に拡散され高い放熱性能が得られる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数の半導体素子を搭載した電子回路基板、及び、その周辺装置が、金属面を有する筐体内に收容されてなる電子機器の冷却装置において、前記複数の半導体素子のうち任意の場所に設置された特定の半導体素子に設けた受熱部と、前記筐体の任意の場所の金属壁面に設けた放熱部と、前記受熱部と前記放熱部とを任意の場所を経由して接続する熱輸送手段とからなることを特徴とする電子機器冷却装置。

【請求項 2】 複数の半導体素子を搭載した電子回路基板、及び、その周辺装置が、金属面を有する筐体内に收容されてなる電子機器の冷却装置において、前記複数の半導体素子のうち任意の場所に設置された特定の半導体素子と、前記筐体の任意の場所の金属壁面とのそれぞれに、内部に液流路を備えたヘッダを設け、前記ヘッダ及び液駆動手段をフレキシブルチューブで接続することにより、前記ヘッダ間で液を駆動させてなる熱輸送手段を備えたことを特徴とする電子機器冷却装置。

【請求項 3】 複数の半導体素子を搭載した電子回路基板、及び、その周辺装置が、金属面を有する筐体内に收容されてなる電子機器の冷却装置において、前記複数の半導体素子のうち任意の場所に設置された特定の半導体素子と、前記筐体の任意の場所の金属壁面とのそれぞれに、内部に液流路を備えたヘッダを設け、前記ヘッダ及び液駆動手段をフレキシブルチューブで接続することにより、前記ヘッダ間で液を往復運動するように駆動させてなる熱輸送手段を備えたことを特徴とする電子機器冷却装置。

【請求項 4】 複数の半導体素子を搭載した電子回路基板、及び、その周辺装置が、金属面を有する筐体内に收容されてなる電子機器の冷却装置において、前記複数の半導体素子のうち任意の場所に設置された特定の半導体素子と、前記筐体の任意の場所の金属壁面とのそれぞれに、内部に液流路を備えたヘッダを設け、前記ヘッダ及び液駆動手段をフレキシブルチューブで接続することにより、前記ヘッダ間で液を循環するように駆動させてなる熱輸送手段を備えたことを特徴とする電子機器冷却装置。

【請求項 5】 請求項 3 または 4 記載の電子機器冷却装置において、前記熱輸送手段は、前記筐体の金属壁面に接続される少なくとも一つのヘッダの内部に形成される流路が、前記筐体の金属壁面に一体形成されていることを特徴とする電子機器冷却装置。

【請求項 6】 請求項 3 または 4 記載の電子機器冷却装置において、前記熱輸送手段は、前記筐体壁に接続される少なくとも一つのヘッダが、筐体壁面に沿って形成した嵌合構造によって設置した金属パイプで構成されていることを特徴とする電子機器冷却装置。

【請求項 7】 請求項 3 または 4 記載の電子機器冷却装置において、前記液駆動手段は前記ヘッダ内に内蔵され

ていることを特徴とする電子機器冷却装置。

【請求項 8】 複数の半導体素子を搭載した電子回路基板、及び、その周辺装置が、金属面を有する筐体内に收容されてなる電子機器の冷却装置において、前記複数の半導体素子のうち任意の場所に設置された特定の半導体素子に金属板を取り付け、該金属板に一本もしくは複数本のヒートパイプの一端を接続し、他端を前記筐体の壁面に沿って形成した嵌合構造によって設置したことを特徴とする電子機器冷却装置。

【請求項 9】 請求項 1、2、3、4 または 8 記載の電子機器冷却装置において、前記筐体壁にはフィンが形成されていることを特徴とする電子機器冷却装置。

【請求項 10】 複数の半導体素子を搭載した電子回路基板、及び、その周辺装置が、金属面を有する筐体内に收容されてなる電子機器の冷却装置において、前記半導体素子を搭載した電子回路基板の特定の半導体素子の搭載された面を前記筐体の金属壁面に対向して設置し、前記半導体素子と前記筐体の金属壁面との間に、柔軟性のある熱伝導部材をはさみ込んだことを特徴とする電子機器冷却装置。

【請求項 11】 請求項 10 記載の電子機器冷却装置において、前記半導体素子と前記筐体内に收容した金属製部材との間に、柔軟性のある熱伝導部材をはさみ込んだことを特徴とする電子機器冷却装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は電子機器冷却装置に係り、特に半導体素子を冷却し所定の温度に保つようにした電子回路基板の冷却に好適な電子機器冷却装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来の電子装置は、特開昭 63-250900 号公報、特開平 3-255697 号公報、実開平 5-29153 号公報に記載のように、独立の金属板、もしくは、筐体の一部を構成する金属板を、発熱部材と金属筐体壁との間に介在させ、発熱部材で発生する熱を放熱部である金属筐体壁まで熱伝導により輸送して放熱している。また、特開昭 55-71092 号公報に記載のように、金属筐体壁面にヒートパイプを形成し、発熱部材を熱的に金属筐体壁と接続することによって、発熱部材で発生する熱を金属筐体壁で放熱している。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 上記従来例で、特開昭 63-250900 号公報、特開平 3-255697 号公報、実開平 5-29153 号公報の例では、発熱部材から金属筐体壁までの伝熱経路が、筐体壁の厚さ 1 mm 前後の薄い断面でしかないため効率よく熱伝導されない。したがって、発熱量の増大に十分対応することができなかった。また、部品配列によっては、必ずしも、金属筐体壁までが短い伝導距離にあるとは限らない。その

ため、発熱部材を筐体近辺に配置するなど、部品配列あるいは筐体構造が制限されていた。一方、高性能が要求される電子機器などにおいて、発熱部材を含む部品配列は、電子回路の高速化に起因する配線長さなどの関係で、性能に大きな影響を及ぼす。したがって、従来例では、電子機器のコンパクト化、高性能化が妨げられていた。また、特開昭 55-71092 号公報の例においても同様に、発熱部材を直接、金属筐体壁に接続しなければならず、発熱部材を含む部品配列あるいは筐体構造が制限されていた。そのため、最適な部品配列を得ることを優先させた場合、発熱部材に個別に放熱フィンを設置する等の方策が必要となり、筐体が大きくならざるを得なかった。

【0004】本発明の目的は、発熱部材が他の部材とともに狭い空間内に搭載された装置であっても、部品配列に左右されずに、発熱部材で発生する熱を放熱部である金属筐体壁まで効率良く輸送し、発熱部材を所定の温度に冷却する電子機器冷却装置を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の電子機器冷却装置は、金属筐体壁を放熱部とし、発熱部材と金属筐体壁とをフレキシブルな構造を有する熱輸送手段によって熱的に接続した。熱輸送手段は、発熱部材に取り付けられる内部に液流路を形成した扁平状のヘッダ部材、金属筐体壁に接触もしくは金属筐体壁に一体成型した流路を有する放熱部、及び、両者を接続するフレキシブルチューブで構成され、内部に封入した液を、液駆動機構を設けて発熱部材に取り付けたヘッダと放熱部との間で液振動あるいは液循環させるようにしたものである。また、発熱部材に取り付けた受熱板と金属筐体壁とを部品配列に応じて折り曲げた細径のヒートパイプで接続した。また、複数の発熱部材が搭載される配線基板を金属筐体壁に対抗させて配置し、発熱部材と金属筐体壁との間に柔軟かつ高熱伝導率の部材をはさみ込んだ。

【0006】

【作用】上記構成によれば、本発明の電子機器冷却装置は、発熱部材に接触させたヘッダと金属筐体壁に接触もしくは金属筐体壁に、一体成型した放熱部材との接続にフレキシブルチューブを用いているので、非常に狭い筐体内に多数の部品が実装された状態においても、部品配列に左右されることなく、発熱部材と放熱部である筐体壁とが容易に接続されるとともに、液の駆動により高効率で熱が輸送される。放熱部においては、放熱部材と金属製筐体壁とが熱的に接続されているので、金属製筐体の高い熱伝導率のために熱が広く筐体壁に拡散され、高い放熱性能が得られる。したがって、効率的に半導体素子を冷却することができる。

【0007】また、発熱部材と金属筐体壁とが部品配列に応じて折り曲げた細径のヒートパイプで接続すること

により、発熱部材で発生する熱が金属製筐体壁まで、部品配列に左右されることなく効率良く輸送される。放熱部においては、金属製筐体の高い熱伝導率のために熱が広く筐体壁に拡散され高い放熱性能が得られる。したがって、効率的に半導体素子を冷却することができる。また、複数の発熱部材と金属筐体壁との間が柔軟な部材で接続されるので、発熱部材間に高さのばらつきがあっても各々の発熱部材と金属製筐体壁とが効率良く熱的に接続されるとともに、金属製筐体の高い熱伝導率のために熱が広く筐体壁に拡散され高い放熱性能が得られる。したがって、効率的に半導体素子を冷却することができる。

【0008】

【実施例】以下、本発明のいくつかの実施例を、図面を参照して説明する。図 1 に、本発明の第 1 の実施例を示す。電子機器は、複数の半導体素子を搭載した配線基板 2、キーボード 4、ディスク装置 6、表示装置 8 などからなり、金属製の筐体 10 の中に収容されている。配線基板 2 に搭載された半導体素子のうち、発熱量の特に大きい半導体素子 12 は、受熱ヘッダ 14、放熱ヘッダ 16、フレキシブルチューブ 18 等で構成される熱輸送デバイスによって冷却される。図示したように、半導体素子 12 と受熱ヘッダ 14 とはサーマルコンパウンド、あるいは、高熱伝導シリコンゴムなどを挟んで接触させ、半導体素子 12 で発生する熱を効率よく受熱ヘッダ 14 に伝える。さらに、半導体素子 12 に接続された受熱ヘッダ 14 はフレキシブルチューブ 18 によって、表示装置 8 の背面部の筐体壁に設置された放熱ヘッダ 16 に接続されている。放熱ヘッダ 16 は、サーマルコンパウンド、あるいは、高熱伝導シリコンゴムを介して、もしくは、直接ねじ 20 止めなどの手段によって金属製筐体壁と熱的かつ物理的に取り付けられる。

【0009】受熱ヘッダ 14、放熱ヘッダ 16 の内部には流路が形成され、液体が封入されている。さらに、放熱ヘッダ 16 の内部には液駆動装置が組み込まれており、受熱ヘッダ 14 と放熱ヘッダ 16 との間で液が駆動される。液体の駆動は、両者間での往復動、あるいは、循環による。受熱ヘッダ 14 と放熱ヘッダ 16 間はフレキシブルチューブによって接続されるので、非常に狭い筐体内に多数の部品が実装された状態においても、実装構造に左右されることなく、高発熱半導体素子と放熱部である筐体壁とが容易に接続できるとともに、熱輸送が液の駆動によって行われるので、高発熱半導体素子で発生する熱は、効果的に放熱ヘッダに輸送される。放熱部においては、放熱ヘッダと金属製筐体壁とが熱的に接続されているので、金属製筐体の高い熱伝導率のために熱が広く筐体壁に拡散され高い放熱性能が得られる。したがって、効率的に半導体素子を冷却することができる。

【0010】図 2 に、図 1 で用いている熱輸送デバイスの詳細を示す。受熱ヘッダ 14、放熱ヘッダ 16 の内部

にはフィンが設けられており、液流路を形成するとともにヘッダ壁より内部の液体に効率よく熱を伝える。さらに、放熱ヘッダ16は、内部に液駆動機構を内蔵している。受熱ヘッダ14は、半導体素子12などの発熱部材（発熱部材1ともいう）の大きさに応じて任意の大きさに設定でき、発熱部材1に接触などの手段によって熱的に接続される。また、金属板（銅、アルミなど）に金属パイプを溶接した構造であってもよい。一方、放熱ヘッダ内部の液駆動機構は、一例として、流路の一部をシリンドラ22としピストン24をモータ26及びリンク機構28によって往復駆動させる機構を示した。放熱ヘッダ16は、金属製の筐体10の壁に取り付けられるが、取付け構造として筐体壁にネジ止め用のボス30をダイカスト成型時に一体で形成してもよい。また、受熱ヘッダ14と放熱ヘッダ16を接続するフレキシブルチューブ18は、樹脂製でよく内径2mm前後のものを用いる。したがって、受熱ヘッダ14、放熱ヘッダ16とも薄型化が可能で、狭い空間に実装された高発熱半導体素子であっても効果的に冷却できる。

【0011】図3に本発明の第2の実施例を示す。本実施例においては、放熱ヘッダ16の取付けられる金属製筐体10のうち表示部側の筐体の内側にフィン32a、32bが一体成型で設けられている。フィン32aの高さは、放熱ヘッダ16の厚さと同程度で、表示器の取り付けに支障をきたさないようにする。また、互いに直角方向にフィンを設けることによって筐体に高い剛性を持たせることができる。ただし、機器使用時において、水平方向になるフィン32bは、鉛直方向のフィン32aよりも高さを低くし、自然対流による上昇空気の流動を妨げないようにしている。さらに、筐体に空気孔34を設け自然対流放熱を促進している。

【0012】図4に本発明の第3の実施例を示す。本実施例においては、熱輸送デバイスを構成する放熱ヘッダの流路36が、金属製筐体10の壁面に金属筐体成型時にダイカストによる一体成型で直接形成されている。放熱ヘッダの流路36は、フレキシブルチューブ18と接続されたフタ38によって密閉され、発熱半導体素子に取り付けられる受熱ヘッダ14と放熱ヘッダの流路36との間で、フレキシブルチューブ18を介して別途設けられる液駆動装置40によって液体が駆動される。液体の駆動は、小型ポンプによる液循環、もしくは、図2で一例として示した液駆動機構が用いられる。本実施例によれば、放熱ヘッダと放熱面である金属製筐体壁面との接触熱抵抗がなくなるので効果的な放熱ができるとともに、放熱ヘッダの流路が金属筐体成型時にダイカストによる一体成型で形成されるため複雑な流路構造の形成も可能である。

【0013】図5に本発明の第4の実施例を示す。本実施例においては、熱輸送デバイスを構成する放熱部が金属製のパイプ42であって、金属製筐体10に直接取付

けられる。金属製パイプ42は、フレキシブルチューブ18にコネクタ44a、44bによって接続され、発熱半導体素子に取り付けられる受熱ヘッダと金属製パイプ42との間で、フレキシブルチューブ18を介して別途設けられる液駆動装置によって液体が駆動される。なお、金属製パイプは、フレキシブルチューブと同程度の内径（2mm前後）のものを持ちいる。一方、筐体壁には、U字状の溝部46が一体成型で設けられており、金属製パイプをこのU字状の溝部46に嵌め込むことによって、特に、溶接などの手段によらずとも効率良く熱的に接続することが可能である。本実施例によれば、放熱部と金属製筐体とが金属製パイプによる線状の接触であっても、金属製筐体の高い熱伝導率のために熱が広く筐体壁に拡散されるとともに、簡単な構造で筐体壁全面に液流路を構成する金属製パイプを設置することも可能で、筐体壁の広い面積を有効に放熱面として利用できる。このため、高い放熱性能が得られる。

【0014】図6に本発明の第5の実施例を示す。電子機器は、複数の半導体素子を搭載した配線基板2、キーボード4、ディスク装置6、表示装置8などからなり、金属製の筐体10の中に収容されている。配線基板2に搭載された半導体素子のうち、発熱量の特に大きい半導体素子12は、受熱ヘッダ14、放熱ヘッダ16、フレキシブルチューブ18等で構成される熱輸送デバイスによって冷却される。半導体素子12と受熱ヘッダ14とはサーマルコンパウンド、あるいは、高熱伝導シリコンゴムなどを挟んで接触させ、半導体素子12で発生する熱を効率よく受熱ヘッダ14に伝える。さらに、半導体素子12に接続された受熱ヘッダ14はフレキシブルチューブ18によって、配線基板等が搭載された本体側の筐体壁に設置された放熱ヘッダ16に接続されている。放熱ヘッダ16は、サーマルコンパウンド、あるいは、高熱伝導シリコンゴムを介して、もしくは、直接ねじ止めなどの手段によって金属製筐体壁と熱的かつ物理的に取り付けられる。受熱ヘッダ14、放熱ヘッダ16の内部には流路が形成され、液体が封入されている。熱輸送デバイスの詳細は、図2で示したものと同様である。ただし、図2で示した放熱ヘッダにおいては、液駆動機構が放熱ヘッダ全体の厚さを規定している。したがって、極めて狭い実装空間しか得られないような装置においては、液駆動装置を放熱ヘッダから分離して設置してもよい。

【0015】図7に本発明の第6の実施例を示す。本実施例では、電子機器は図6と同様な構成になっており、熱輸送デバイスとして直径2mm前後の細径ヒートパイプ50を用いている。ヒートパイプ50は、1本、又は、複数本で発熱量の特に大きい半導体素子12を冷却する。ヒートパイプの端部は、半導体素子面が一様な温度に冷却されるようにアルミあるいは銅の受熱板48を介して半導体素子で発生する熱がヒートパイプに伝熱さ

れる。ヒートパイプと受熱板とは溶接あるいは嵌合によって小さい接触熱抵抗で接続される。一方、放熱側は、ヒートパイプが放熱面である金属製筐体 10 の壁面に直接取り付けられる。筐体壁には、U 字状の溝部 52 が一体成型で設けられており、ヒートパイプをこの U 字状の溝部 52 に嵌め込むことによって、特に、溶接などの手段によらなくても効率良く熱的に接続することが可能である。なお、本実施例では細径のヒートパイプを用いているので、部品配列に応じて折り曲げて配置し、それぞれのヒートパイプをそれぞれ任意の場所に配置することができる。従って、本実施例によれば、部品の配列状態にかかわらず半導体素子で発生する熱を効率良く放熱部に輸送することができるとともに、放熱部と金属製筐体とがヒートパイプによる線状の接触であっても、金属製筐体の高い熱伝導率のために熱が広く筐体壁に拡散されるため筐体壁の広い面積を有効に放熱面として利用できる。このため、極めて少ない空間であっても細長部のみの設置スペースでよく、かつ、高い放熱性能が得られる。

【0016】図 8 および図 9 に、それぞれ本発明の第 7 および第 8 の実施例を示す。本実施例の電子機器は、配線基板 2 等が収納される筐体 10 の上部に表示装置 8 が設置されており、実装空間が極めて制限されている。図 8 では、配線基板 2 に搭載された半導体素子のうち、発熱量の特に大きい半導体素子 12 は、受熱ヘッダ 14、放熱ヘッダ 16、フレキシブルチューブ 18 等で構成される熱輸送デバイスによって冷却される。半導体素子 12 と受熱ヘッダ 14 とはサーマルコンパウンド、あるいは、高熱伝導シリコンゴムなどを挟んで接触させ、半導体素子 12 で発生する熱を効率よく受熱ヘッダ 14 に伝える。さらに、半導体素子 12 に接続された受熱ヘッダ 14 はフレキシブルチューブ 18 によって、配線基板等を搭載した筐体 10 の壁面に設置された放熱ヘッダ 16 に接続されている。放熱ヘッダ 16 は、サーマルコンパウンド、あるいは、高熱伝導シリコンゴムを介して、もしくは、直接ねじ止めなどの手段によって金属製筐体 10 の壁と熱的かつ物理的に取り付けられる。取り付け位置は、筐体側面など比較的スペースに余裕のある場所であるが、特に、制限されることはない。なぜなら、放熱部において、金属製筐体の高い熱伝導率のために熱が広く筐体壁に拡散され、筐体壁の広い面積を有効に放熱面として利用できるとともに、フレキシブルチューブ 18 によって受熱ヘッダ 14 と放熱ヘッダ 16 が部品配列に左右されずに接続できるためである。

【0017】一方、図 9 では、電子機器は図 8 と同様な構成になっており、熱輸送デバイスとしてヒートパイプ 50 を用いている。ヒートパイプ 50 は、1 本、又は、複数本で発熱量の特に大きい半導体素子 12 を冷却する。ヒートパイプ 50 の端部は、図 7 に示した例と同様、金属製の受熱板 48 を介して半導体素子で発生する

熱がヒートパイプ 50 に伝熱される。一方、放熱側は、ヒートパイプが放熱面である金属製筐体 10 の壁面（本体側面など）に直接取り付けられる。筐体 10 の壁には、U 字状の溝部 52 が一体成型で設けられており、ヒートパイプ 50 をこの U 字状の溝部 52 に嵌め込むことによって、特に、溶接などの手段によらなくても効率良く熱的に接続することが可能である。本実施例によれば、ヒートパイプと金属製筐体とは細長部のみの設置スペースでよく、筐体内で放熱のために使用できる空間が極めて少ない電子機器であっても、効率の良い放熱ができる。

【0018】図 10 に本発明の第 9 の実施例を示す。本実施例においては、電子機器を構成する配線基板 2 のうち、発熱量の特に大きい半導体素子 12a, 12b を含む基板を別の電子回路基板 54 として分離し、両者をコネクタ 56 で電気的に接続している。分離する電子回路部は、回路の動作速度を考慮して複数の半導体素子を含むことができる。高発熱部を含む基板 54 は、発熱量の特に大きい半導体素子面を金属筐体 10 に対向させて設置し、半導体素子面と金属筐体との間に柔軟性を有しかつ熱伝導性に優れた部材である高熱伝導柔軟部材 58（たとえば、Si ゲル、もしくは、袋状に形成したフィルム中に熱伝導性グリスを封入したもの等）をはさみこんでいる。図 10 では、筐体底面部を放熱面とした例を示したが、本実施例によれば、スペースが許せば、筐体上面部あるいは側面部を放熱面としてもよい。本実施例によれば、複数の発熱部材と金属筐体壁との間が柔軟な部材で接続されるので、発熱部材間に高さのばらつきがあっても各々の発熱部材と金属製筐体壁とが効率良く熱的に接続されるとともに、金属製筐体の高い熱伝導率のために熱が広く筐体壁に拡散され高い放熱性能が得られるとともに、筐体壁が部分的に高い温度になることがない。

【0019】図 11 に本発明の第 10 の実施例を示す。本実施例は図 10 と同様な構造で、電子機器を構成する配線基板 2 を、発熱量の特に大きい半導体素子 12a, 12b を含む面を金属筐体 10 に対向させて設置し、半導体素子面と金属筐体との間に高熱伝導柔軟部材 58 をはさみこんでいる。図 11 では、図 10 と同様、筐体底面部を放熱面とした例を示したが、たとえば、キーボード 4 を支持している金属板 60 を放熱面として、図中に点線で示すように、配線基板 2 及び高熱伝導柔軟部材 58 を設置しても良い。

【0020】

【発明の効果】本発明によれば、高発熱半導体素子が他の部材とともに狭い空間内に搭載された装置であっても、部材の配置状態に左右されずに、高発熱半導体素子で発生する熱を放熱部まで効率良く輸送するとともに、放熱部が金属製筐体壁に接続されているので、熱が広く筐体壁に拡散され筐体壁の広い面積を有効に放熱面として利用でき、高い放熱性能が得られる。したがって、効

率的に半導体素子を冷却することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の第 1 の実施例の斜視図。

【図 2】 図 1 の実施例の詳細斜視図。

【図 3】 本発明の第 2 の実施例の斜視図。

【図 4】 本発明の第 3 の実施例の構成説明図。

【図 5】 本発明の第 4 の実施例の斜視図。

【図 6】 本発明の第 5 の実施例の斜視図。

【図 7】 本発明の第 6 の実施例の斜視図。

【図 8】 本発明の第 7 の実施例の斜視図。

【図 9】 本発明の第 8 の実施例の斜視図。

【図 10】 本発明の第 9 の実施例の斜視図。

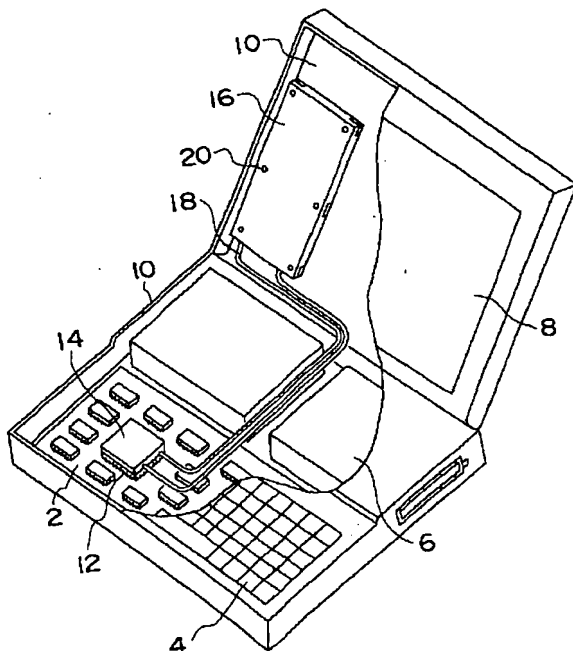
【図 11】 本発明の第 10 の実施例の断面図。

【符号の説明】

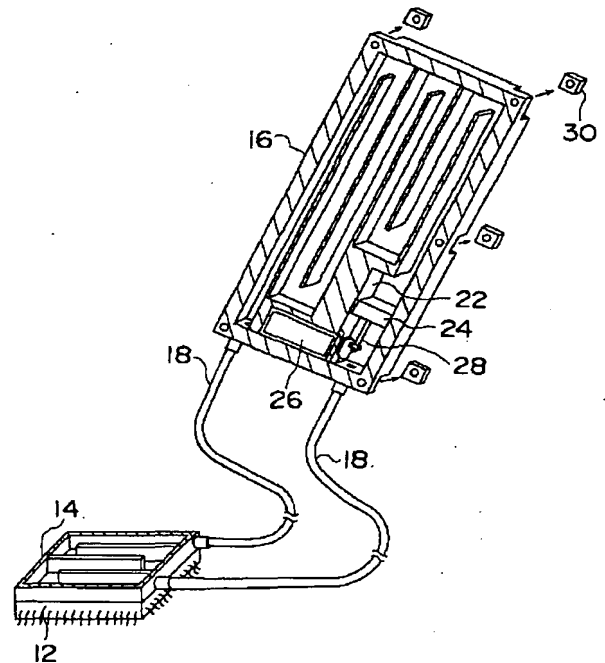
- 2 配線基板
- 4 キーボード
- 6 ディスク装置
- 8 表示装置
- 10 金属製筐体
- 12 半導体素子発熱部材
- 14 受熱ヘッダ
- 16 放熱ヘッダ

- 18 フレキシブルチューブ
- 20 ねじ
- 22 シリンダ
- 24 ピストン
- 26 モータ
- 28 リンク機構
- 30 ボス
- 32 a, 32 b フィン
- 34 空気孔
- 36 流路
- 38 フタ
- 40 液駆動装置
- 42 金属製パイプ
- 44 a, 44 b コネクタ
- 46 U字状の溝部
- 48 受熱板
- 50 ヒートパイプ
- 52 U字状の溝部
- 54 電子回路基板
- 56 コネクタ
- 58 高熱伝導柔軟部材
- 60 金属板

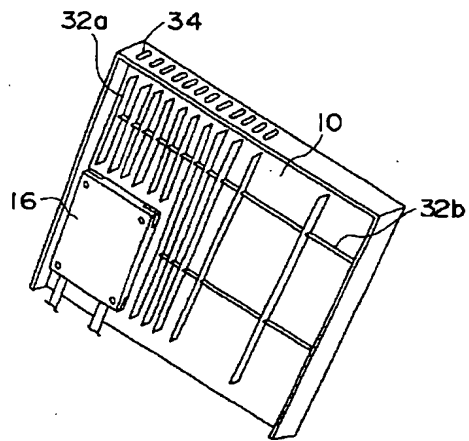
【図 1】



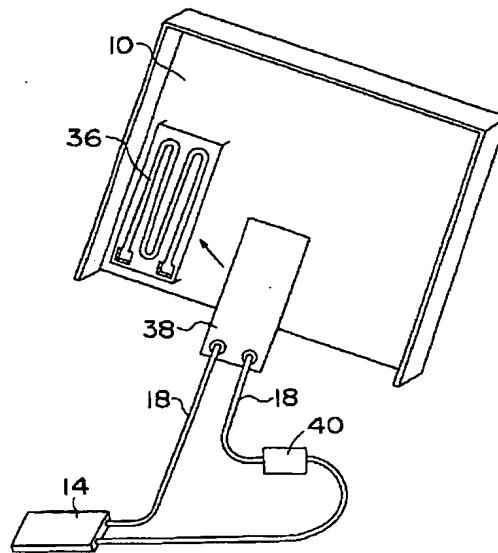
【図 2】



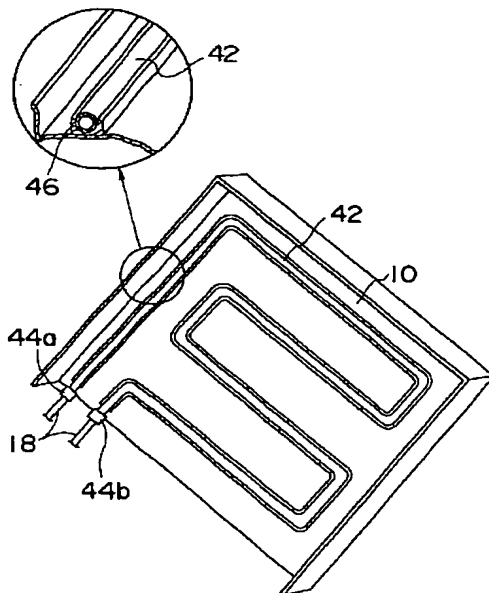
【図 3】



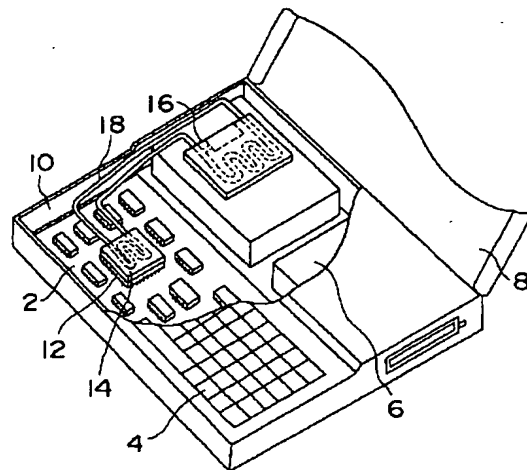
【図 4】



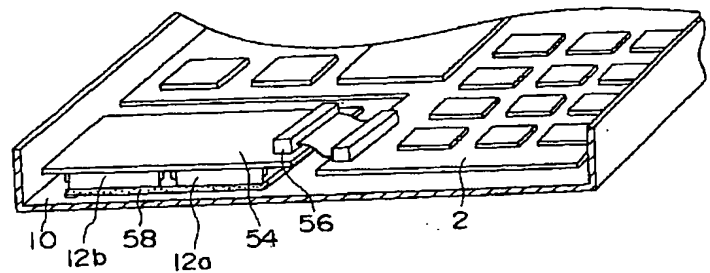
【図 5】



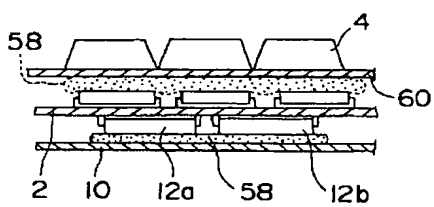
【図 6】



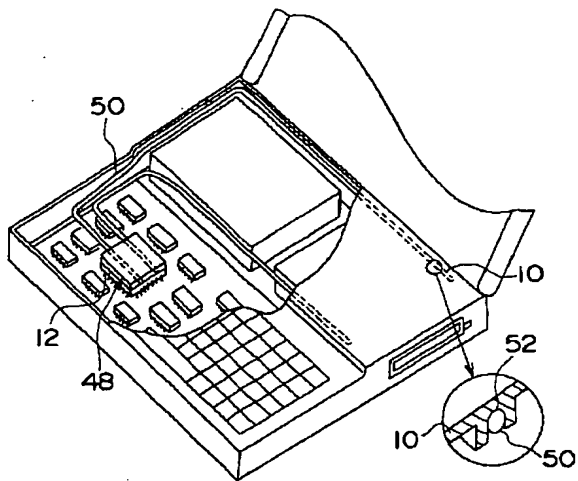
【図 10】



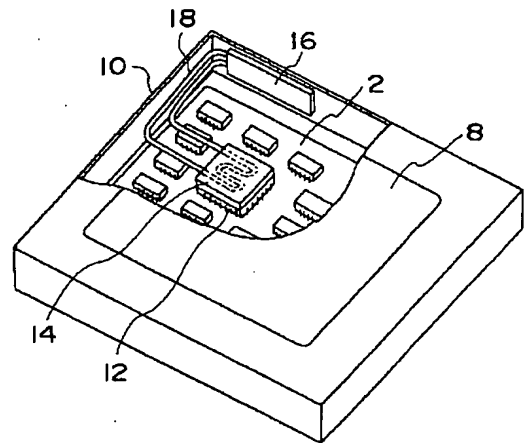
【図 11】



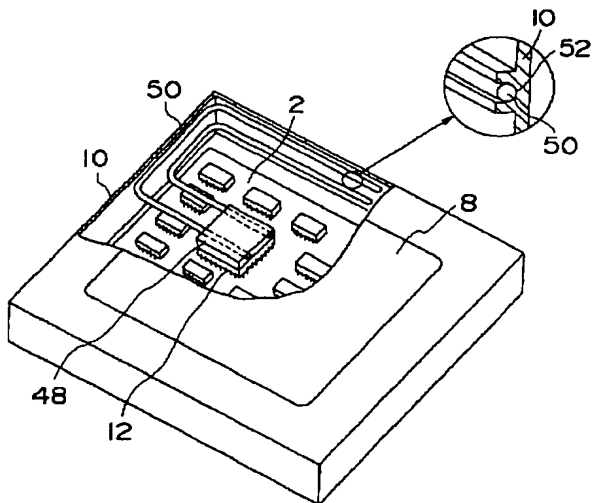
【図7】



【図8】



【図9】



【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 13 年 9 月 14 日 (2001. 9. 14)

【公開番号】特開平 7-142886
 【公開日】平成 7 年 6 月 2 日 (1995. 6. 2)
 【年通号数】公開特許公報 7-1429
 【出願番号】特願平 5-284855
 【国際特許分類第 7 版】
 H05K 7/20

H01L 23/473
 【F I】
 H05K 7/20 R
 F
 H01L 23/46 Z

【手続補正書】

【提出日】平成 12 年 11 月 6 日 (2000. 11. 6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】発明の名称
 【補正方法】変更
 【補正内容】

【発明の名称】電子機器装置

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 内部に半導体素子を搭載した第 1 の筐体と、内部に表示装置を収納し、前記第 1 の筐体に回転支持された第 2 の筐体とを備えた電子機器において、前記半導体素子と熱的に接触した受熱部材と、前記第 2 の筐体内面と熱的に接触した放熱部材と、この受熱部材と前記放熱部材との間で液媒体を駆動させる液駆動手段と、前記受熱部材と前記放熱部材と前記液駆動手段を接続するチューブとを備え、前記液駆動手段を前記第 1 の筐体内に収納したことを特徴とする電子機器装置。

【請求項 2】 内部に半導体素子を搭載した第 1 の筐体と、内部に表示装置を収納し、前記第 1 の筐体に回転支持された第 2 の筐体とを備えた電子機器において、前記半導体素子と熱的に接触した受熱部材と、前記第 2 の筐体内面と熱的に接触した金属製パイプと、前記受熱部材と前記金属製パイプとの間で液媒体を駆動させる液駆動手段とを備え、前記受熱部材と前記放熱部材との間をフレキシブルチューブで接続し、前記金属製パイプと前記液駆動手段をフレキシブルチューブで接続したことを特

徴とする電子機器装置。

【請求項 3】 前記第 2 の筐体が金属であることを特徴とする請求項 1～2 に記載の電子機器装置。

【請求項 4】 前記受熱部材が第 1 の筐体内面に接触していることを特徴とする電子機器装置。

【請求項 5】 前記放熱部材を前記第 2 の筐体と一体に形成したことを特徴とする電子機器装置。

【請求項 6】 前記液駆動手段を前記第 1 の筐体内に収納したことを特徴とする電子機器装置。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0001
 【補正方法】変更
 【補正内容】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は電子機器装置に係り、特に半導体素子を冷却し所定の温度に保つようにした電子回路基板の冷却に好適な電子機器冷却装置に関する。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0005
 【補正方法】変更
 【補正内容】

【0005】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の電子機器装置は、金属筐体壁を放熱部とし、発熱部材と金属筐体壁とをフレキシブルな構造を有する熱輸送手段によって熱的に接続した。熱輸送手段は、発熱部材に取り付けられる内部に液流路を形成した扁平状のヘッダ部材、金属筐体壁に接触もしくは金属筐体壁に一体成型した流路を有する放熱部、及び、両者を接続するフレキシブルチューブで構成され、内部に封入

した液を、液駆動機構を設けて発熱部材に取り付けたヘッドと放熱部との間で液振動あるいは液循環させるようにしたものである。また、発熱部材に取り付けた受熱板と金属筐体壁とを部品配列に応じて折り曲げた細径のヒートパイプで接続できる。また、複数の発熱部材が搭載される配線基板を金属筐体壁に対抗させて配置し、発熱部材と金属筐体壁との間に柔軟かつ高熱伝導率の部材をはさみ込むこともできる。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 6

【補正方法】変更

【補正内容】

【0 0 0 6】

【作用】上記構成によれば、本発明の電子機器装置は、発熱部材に接触させたヘッドと金属筐体壁に接触もしくは金属筐体壁に、一体成型した放熱部材との接続にフレキシブルチューブを用いているので、非常に狭い筐体内に多数の部品が実装された状態においても、部品配列に左右されることなく、発熱部材と放熱部である筐体壁とが容易に接続されるとともに、液の駆動により高効率で熱が輸送される。放熱部においては、放熱部材と金属製筐体壁とが熱的に接続されているので、金属製筐体の高い熱伝導率のために熱が広く筐体壁に拡散され、高い放熱性能が得られる。したがって、効率的に半導体素子を冷却することができる。